

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
28. April 2005 (28.04.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/038907 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 23/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/010262

(22) Internationales Anmeldedatum:  
14. September 2004 (14.09.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 45 157.9 29. September 2003 (29.09.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-  
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DÜSBERG, Georg

Stefan [DE/DE]; Aurbacher Strasse 3, 81541 MÜNCHEN  
(DE). STEINHÖGL, Werner [DE/DE]; Rosen-  
buschstrasse 3, 80538 MÜNCHEN (DE).

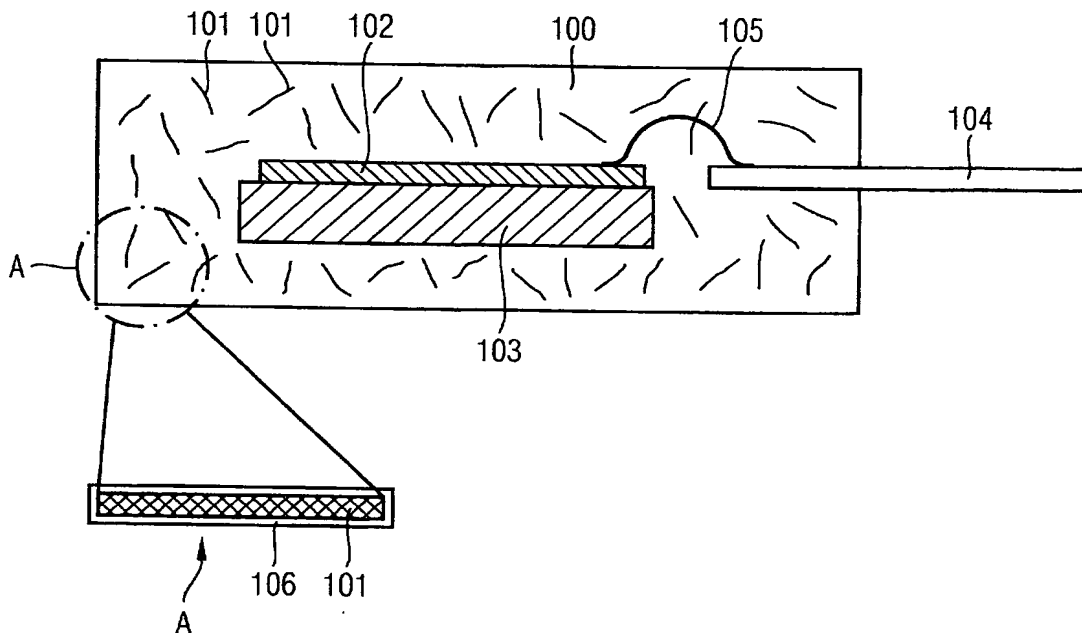
(74) Anwalt: BARTH, Stefan; REINHARD, SKUHRA,  
WEISE & PARTNER GbR, Friedrichstrasse 31, 80801  
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HEAT-CONDUCTING COATING OF ELECTRONIC CIRCUIT ASSEMBLIES

(54) Bezeichnung: WÄRMELEITENDE VERPACKUNG VON ELEKTRONISCHEN SCHALTUNGSEINHEITEN



(57) Abstract: The invention relates to a heat-conducting coating of electronic circuit assemblies (102), comprising a coating agent (100), which encloses the electronic circuit assembly (102) and which is electrically insulating, with dispersed particles in the coating agent (100) which have a high thermal conductivity, whereby the particles dispersed in the coating agent (100) are embodied as nanoelements (101).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/038907 A2



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**Veröffentlicht:**

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

---

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung schafft eine Verpackungsvorrichtung zur Verpackung elektronischer Schaltungseinheiten (102), die ein Verpackungsmittel (100), das die elektronische Schaltungseinheit (102) umgibt und das elektrisch isolierend ist, und in dem Verpackungsmittel (100) dispergierte Partikel aufweist, welche eine hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, wobei die in den Verpackungsmittel (100) dispergierten Partikel als Nanoelemente (101) ausgebildet sind.